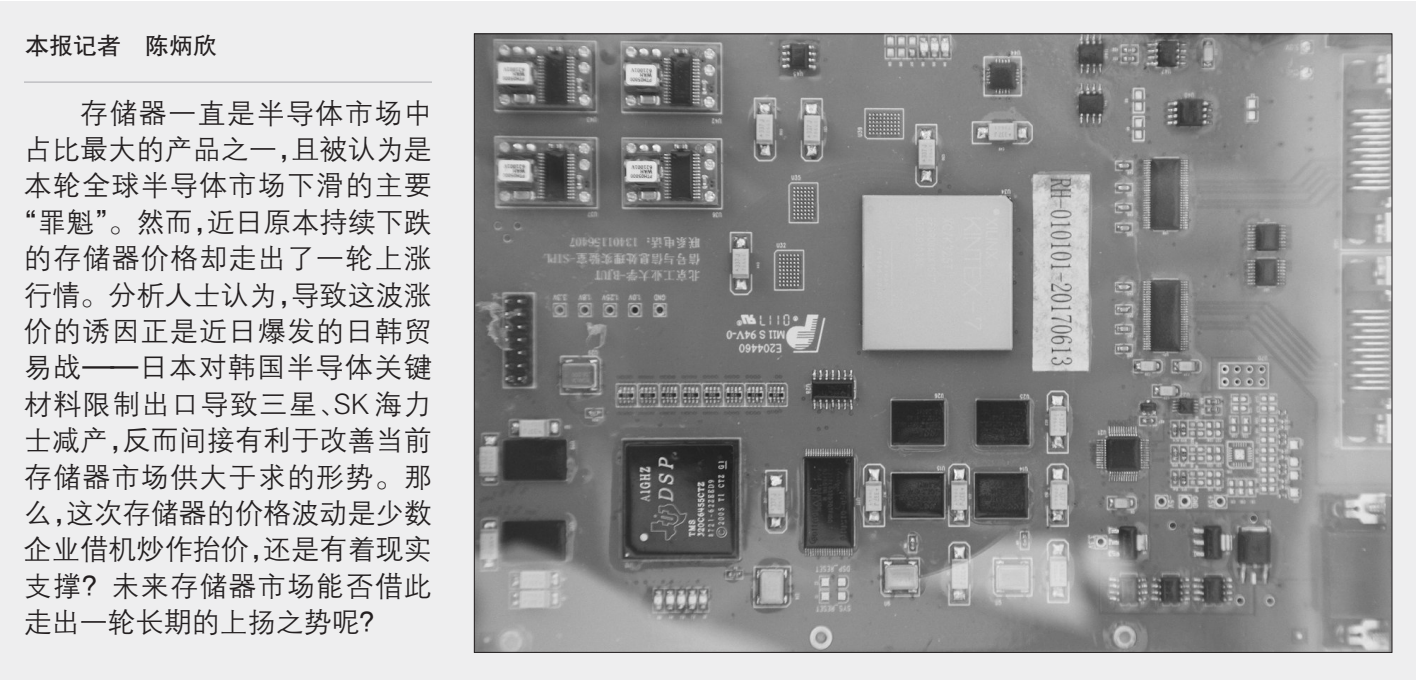


存储器价格小幅上涨 长期走势尚需观察



在限令实行的3个月后，NAND闪存市场将会“极度”混乱，其他非韩厂的内存厂商，将会因此受益。

在经历了接近一年“跌跌不休”的局面后，近日国际存储器价格出现了一轮小幅上涨的行情。根据调研机构集邦咨询旗下DRAMeXchange数据，7月10日8GB DDR4 DRAM均价较前一天上涨1.2%。这是去年9月以来，现货价首次上涨。

此外，部分内存模组厂商如威刚等已经开始限量供应现货产品。而随着报价的反弹，具备NAND芯片制造能力的旺宏、华邦等厂，以及内存模组厂威刚、创见、十铨、群联、宇瞻和广颖等受益明显，营运有望大幅提升。

那么，是什么导致了此轮存储器的涨价呢？一些市场分析人士将原因指向近日爆发的日韩贸易战。由于韩国企业三星、SK海力士占据全球存储器市场的主导地位，DRAM市场，三星占全球份额的43.9%，SK海力士为29.5%；NAND闪存市场，三星为36.5%，SK海力士为10.5%。在日韩贸易战影响下，两家公司均有可能缩减存储器产能。但是，由于目前国际市场上DRAM和NAND闪存都存在着供过于求的隐忧。因此，这对存储器市场来说反而是个好消息。

据韩国《经济日报》报道，三星和SK海力士正在考虑从本月开始减少NAND闪存产量。“对产量下降的预期可能会抬高价格。”首尔DB Financial Investment分析师Kwon Sung-ryul表示。

内存厂旺宏董事长吴敏求也认为，在日本政府对半导体关键材料出口韩国祭出限令的情况下，短期内虽有库存可供给需求，长期来看一定会造成缺货，在限令实行的3个月后，NAND闪存市场将会“极度”混乱。在供不应求的情况下，其他非韩厂的内存厂商，将会因此受益。

事实上，这并不是存储厂商第一次在重大事件中受益。2013年，SK海力士在中国无锡工厂的火灾影响了全球DRAM产量的6%，并使这些芯片的价格一度飙升了约88%。

虽然市场上免不了存在一定的炒作，但是，本轮存储器价格上涨也有一定现实支撑的。

那么，这轮存储器涨价的背后，是否有着借机炒作抬价的嫌疑呢？集邦咨询研究协理陈玠玮表示：“以NAND闪存合约价来看，目前观察到报价确实是有所上涨。”也就是说，虽然市场上免不了存在一定的炒作，不过，本轮价格上涨也有一定现实支撑。

事实上，在日韩贸易战发生之前，NAND闪存市场已经有了库存快速消化的迹象，并且出现存储器价格将结束长期跌势的呼声。上个月，受到日本强震影响，东芝公司NAND闪存工厂产量减少20%以上。

此次事件不仅对东芝的产量造成影响，而且西部数据也在东芝的制造工厂生产NAND闪存，同样受到重创。由于东芝和西部数据的市场份额分别高达19.3%和15.3%，这已经在一定程度上形成减产、降库存的效果，对存储器价格形成了支撑。

陈玠玮甚至认为，近期存储价格的小幅上涨主要是受到东芝部分工厂停电的影响。“日韩贸易战目前更多还只是停留在消息面上。”陈玠玮说。

DRAM市场出现反转的时间点有可能落在2020年第二季度末至第三季度以内。届时有可能出现终端的旺季需求。

长期来看，存储市场将会如何发展？未来存储器能否借助此次事件的影响，走出一轮长期的上扬之势呢？

集邦咨询认为，消息面只能影响短期市场走势，长期变化还需看市场的供需形势。DRAM价格已然经历了连续三个季度的快速下滑，下游模组厂的库存普遍偏低。因此，在日韩贸易战消息的影响下，确实有部分模组厂开出上扬的价格或表示将停止生产。然而，现货市场只占整体DRAM市场的10%，中长期产业的供需态势仍关注占比超过9成的合约市场。

集邦咨询资深协理吴雅婷表示：“目前DRAM仍处于买方市场，原厂库存只能降价求售。接下来价格何时反转，仍然取决于需求面何时出现大幅增长。”

但从需求面来看，不论是零售端的PC、智能手机，还是企业用服务器与数据中心的建设，目前整体终端需求仍然呈现十分疲弱的态势。因此，DRAM市场短期可能会受到日韩贸易战消息的影响，但却很难就因此得出市场将出现结构性供需反转的结论。

吴雅婷预估，DRAM市场出现反转的时间点有可能落在2020年第二季度末至第三季度以内。届时有可能出现终端的旺季需求，带动存储器的库存消化，进而推升价格。

至于NAND闪存市场，由于NAND闪存晶圆的市场报价已经偏低，预计7月起各供应商报价将出现涨势。集邦咨询认为，由于供应商普遍备有2至3个月的库存，多数模组厂不会第一时间接受涨价，后续则需视市场及供应端库存状况决定交易价是否上涨。虽然NAND闪存价格短期将出现上扬，但长期仍有跌价的压力。

Arm中国打造AIoT开发者之家

本报讯 7月18日，Arm中国正式发布了由其发起的“极术AIoT开发者社区”。该社区由Arm中国携手中国领先的中文技术交流平台思否(SegmentFault)以及Arm中国生态重要合作伙伴开放智能机器(OPEN AI Lab)和移知科技，专门为中国AIoT开发者搭建，旨在为广大的软硬件开发者提供一个自由交流的平台和答疑解惑的渠道，借助强大的Arm全球及中国生态系统资源，助力中国开发者轻松地进入AIoT领域，将更多创意和创新付诸实践，积极应对下一波万亿智能互联技术浪潮所代表的巨大的市场机遇。

近年来，人工智能和物联网技术的迅猛发展引人注目，而二者结合所形成的人工智能物联网(即AIoT)被普遍认为将成为未来引领全球新一轮革命性技术演进的核心应用。根据预计，到2035年，全球智能互联设备的数量将超过一万亿台。作为全球唯一一个能够覆盖从传感器到终端到云的技术架构，Arm全球客户出货量累计已经超过1450亿台，众多开发者都在基于Arm技术进行创新设计。

中国拥有全球最大的开发者群体，从芯片、硬件、软件、云计算到AI，活跃在各个领域的中国开发者，共同推动了科技的发展。

极术社区是一个问答型交互社区，首批发布包括人工智能、芯片硬件和全球资源三大板块，希望在人工智能技术、SoC开发以及Arm人工智能全球生态对接三个重要领域为中国开发者提供一个强大的互动平台。

Arm中国市场部负责人梁泉表示：“人工智能、物联网和5G技术一起带来了第五波计算浪潮，促生了AIoT的迅猛发展，也开启了新一轮的技术融合与交流。在这波浪潮中，AIoT开发者来自各个领域，使用多种技术框架，全栈开发和混合开发都拥有相当的市场，这就给开发者跨越技术边界、加强持续学习能力提出很高的要求。目前，全球90%的物联网设备控制器和90%的人工智能设备都是基于Arm IP，而Arm所取得的成功，正是来自于开放的技术和开放的生态，其中很重要的一部分就是开源社区和开放交流。我们希望把极术社区打造成AIoT开发者之家，与大家一起共建面向未来的智能科技生态。”

2019年全球电脑加手机 出货量将下降3%

本报讯 7月19日，根据全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner的预测，2019年全球设备(个人电脑、平板电脑和手机)的总出货量将达到22亿台，比去年下降3.3%。

手机市场将下降3.8%，成为这些设备中表现最差的类型。Gartner研究总监Ranjit Atwal表示：“目前，手机市场的出货量为17亿台，比2015年同期的19亿台减少了约10%。如果手机无法提供显著的新功能、效率或体验，那么用户就不愿去更换，而这将延长这些设备的使用寿命。”

2018年，手机使用寿命开始呈现出延长趋势，并且这一趋势将在2019年持续下去。Gartner预测，高端手机的使用寿命将从2.6年增加到2023年的近2.9年。Gartner预计2019年智能手机的销售量将下降2.5%，这将是迄今为止的最大降幅。

今年早些时候，移动运营商在美国、

韩国、瑞士、芬兰和英国的部分地区推出了5G服务，但运营商仍需要一定的时间将5G网络扩展到主要城市以外的地区。

到2020年，Gartner预计7%的全球通信服务提供商将推出商业无线5G服务。这将标志着2018年的5G概念验证和商用网络建设工作取得了重大的进展。

2019年上半年，几家手机制造商推出了支持5G的智能手机。为了改善智能手机销售减缓的情况，移动设备制造商计划在2020年推出价格更优惠的5G手机。

Atwal表示：“到2020年，具备5G功能的手机将占手机总销售量的6%。随着5G服务覆盖范围的扩大，用户体验将变得更好并且价格也会下降。5G手机将在2023年出现巨大增长，预计将占手机销售量的51%。”

尽管2019年第二季度的全球PC出货量达到6300万台并实现了1.5%的增长，但2019年的PC需求仍存在不确定性。2019年的PC出货量预计为2.57亿台，比2018年下降1%。

东芝停电厂房复工时间慢于预期 第三季度晶圆报价短期面临涨价压力

本报讯 近日，东芝存储器公司四日市厂区遭遇长约13分钟的跳电，新Fab2、Fab3、Fab4、Fab5以及Fab6全体厂区皆受到冲击。目前，整个厂房的营运仍未完全恢复。对此，集邦咨询旗下半导体研究中心(DRAMeXchange)评估，此事件将使得晶圆短期内报价面临涨价压力，第三季度2D NAND Flash产品价格可能上涨，3D NAND Flash产品价格跌幅则可能小幅收敛。

东芝与西数分别发布关于此事件的公开说明，其中西数表示约有6ExaByte

(EB)的产能将受到冲击，大部分影响将发生在今年第三季度。

对于3D NAND架构为主的eMMC/UFS以及SSD等主流产品，在买卖双方皆有高库存支持下，第三季度合约价走势态势不致翻转，但跌幅可能略微收敛，而在晶圆及渠道零售市场，由于西数占有相当市场影响力，同时美光亦宣布扩张减产幅度至10%，加上今年市场已长期处在接近成本线的压力，集邦咨询预期将为晶圆报价带来短期调涨压力，但还需看客户接受程度。

索尔维可持续交通和资源 高效化解决方案亮相

本报讯 近日，索尔维在德国杜赛尔多夫国际塑料及橡胶博览会(2019K展)期间展示其在热塑性复合材料方面最新的成果，此类轻量化材料将促进集团实现在可持续交通领域的目标，为航空、汽车、油气行业的客户实现资源利用高效化。

索尔维打造了一个专注于热塑性复合材料的平台，将复合材料及无与伦比的高性能聚合物产品系列进行垂直化整合，并充分利用内部优异的专业化能力。这类新材料除了轻量化的优势，还具有优异的耐热性、抗冲击性、强度、韧性、化学惰性，以及设计

灵活性。

除了展示热塑性复合材料的开发成果外，索尔维还将推出一款行业首创的新型耐高温聚醚醚酮(PEEK)聚合物。在K展期间，索尔维还将展示其高性能材料独特的市场应用。例如全球第一辆由索尔维长纤维热塑性塑料制成的全聚合物回收型电动自行车。

展会上，索尔维还将围绕可持续交通和资源高效化两大主题，展开各类话题的演讲，涵盖电池、增材制造、超高速互联、交通、水过滤、建筑和消费品等领域。

意法半导体双接口安全微控制器 提升安全性和便捷性

本报讯 7月18日，意法半导体新推出的ST31P450双接口安全微控制器采用最新的40nm闪存工艺以及强化的RF射频技术，为银行卡、身份证、交通卡、付费电视等非接触式智能卡带来优异的连接稳健性和读写性能。

ST31P450基于经过市场检验的32位Arm SecurCore SC000安全处理器，符合ISO 7816和ISO 14443 A类智能卡和非接触式智能卡标准，支持MIFARE全系软件库，包括MIFAREClassic、MIFAREPlus和MIFAREDESFire。意法半导体的40nm闪

存技术可以将芯片做得极小，适用于银行卡等双接口应用场景，增强的安全性可提高交易安全性和防伪功能。

ST31P450的新低功耗加密引擎可最大程度地降低能耗预算，当射频场强较弱时，在保证优异的读写性能的同时还能执行加密运算。ST31P450还配备优化的装载固件，让卡片发行商发卡后的维护服务变得更轻松。

ST31P450安全微控制器及其相关的加密库有望在未来几个月内取得Common Criteria EAL5+以及EMVCo和CUP(中国银联)的安全认证。

Vishay小型表面贴UVC发光二极管 用于消毒和净化

本报讯 7月17日，Vishay Intertechnology宣布，推出新型短波紫外线(UVC)发光二极管小型表面贴器件——VLMU35CL-280-120，用于杀菌、消毒和净化。VLMU35CL-280-120专门用于取代UVC水银灯，具有极长使用寿命，采用3.5mm×3.5mm×1.2mm表面贴封装，配有石英窗口，不需要外置透镜。

日前发布的器件发射角为±60°，20mA条件下辐射功率为3.2mW，50mA条件下为7.5mW。

VLMU35CL-280-12采用AlGaN技术，最大正向电流为6.5V，波长范围265nm至285nm，正向电流70mA，相比之下，典型同类产品为30mA。

发光二极管性能特别适合用于水和空气净化、物理方式表面杀菌、医院消毒以及便携式消毒设备。VLMU35CL-280-120符合RoHS和Vishay绿色标准，无卤素，适合采用回流焊工艺，潮湿敏感度等级达到J-STD-020标准3级。

新款UVC发光二极管现可提供样品并已实现量产，供货周期为四周到六周。